

株式の状況

株式数及び株主数 (2024年3月31日現在)	
発行可能株式総数	7,800,000株
発行済株式総数	3,909,800株
株主数	1,181名

大株主 (2024年3月31日現在)		
	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社アルゴグラフィックス	1,980,000	50.6
セイコーインスツル株式会社	816,000	20.9
ジーダット従業員持株会	53,700	1.4
兼浜 勝弘	51,000	1.3
久保田 正明	40,000	1.0
若林 敬三	28,000	0.7
株式会社SBI証券	25,200	0.6
尾崎 敬郎	21,900	0.6
株式会社エスケーエレクトロニクス	18,000	0.5
大日本印刷株式会社	18,000	0.5

所有者別状況 (2024年3月31日現在)		
所有者区分	持株数(株)	持株比率(%)
金融機関	3,300	0.1
証券会社	69,128	1.8
その他国内法人	2,841,015	72.7
外国法人等	74,200	1.9
個人・その他	861,685	22.0
自己名義株式	60,472	1.5
計	3,909,800	100.0



本社 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel: 03-6262-8400 (代)
当冊子に関するお問い合わせ先 株式会社ジーダット 経営管理本部 E-mail: corporate.planning1@jedat.co.jp

株主メモ

上場市場	東京証券取引所 スタンダード市場
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 (https://www.jedat.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

株式事務のお問い合わせ先

住所変更、株式配当金受取り方法の変更及びマイナンバーのお届出などのお問い合わせ	お取引の証券会社等になります。
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ	みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせ	お取引の証券会社またはみずほ信託銀行へお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い	・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。

表紙の絵は、江戸時代に歌川広重が描いた鐵砲洲の情景です。江戸の入り口として日本の全国各地から廻船が集まった歴史あるこの地から、JEDATは日本EDAの最先端技術を世界へ発信いたします。



株式会社ジーダット

証券コード:3841

第22期 株主通信

自2023年4月1日 至2024年3月31日



歌川広重「鐵砲洲側真景」国立国会図書館所蔵



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



JEDAT は Japan EDA Technologies の略です。

私たちは、日本の EDA のリーダーとして、電子産業の発展に貢献したいと考えています。

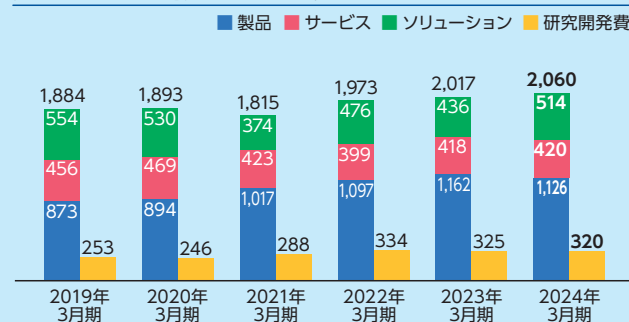
EDA とは Electronic Design Automation の略です。

電子機器や電子部品の設計作業を支援、検証するソフトウェア（電子系 CAD）で、設計作業には不可欠なツールであり、設計期間の短縮や設計品質の向上を実現します。

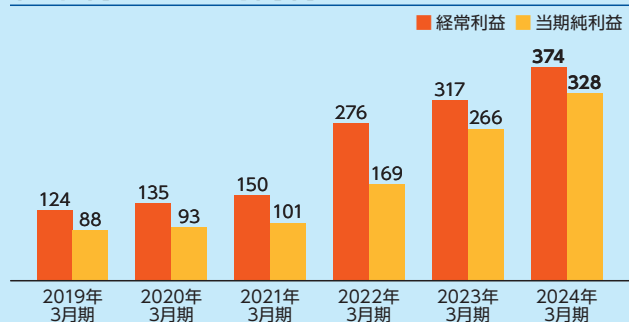
財務ハイライト

(単位：百万円)

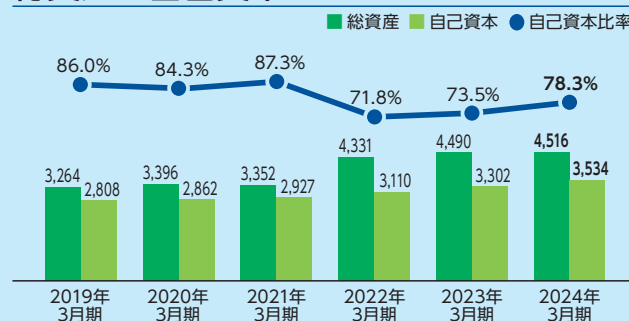
売上高・研究開発費



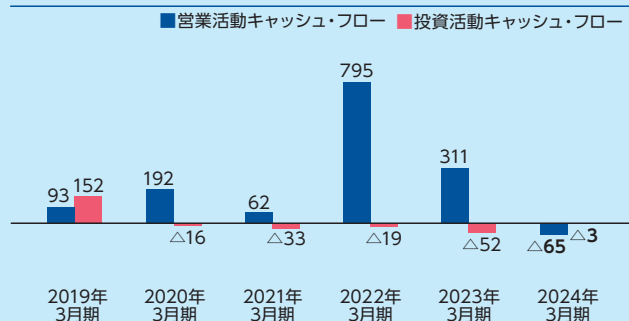
経常利益・当期純利益



総資産・自己資本



キャッシュ・フロー



ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当第22期における当社の売上高は、デバイス設計受託サービスの売上が大幅に伸長したこともあり、前期比2.1%増となる20億60百万円、営業利益は同13.1%増の3億2百万円となりました。当事業年度における当社の活動といたしましては、UI (User Interface) の機能拡張で使い勝手を大幅に向上した主力製品：SX-MeisterのVer.16.0をリリース、デバイスレベル自動配置・配線ツールを新たに追加し、継続した機能拡張を行ってまいりました。平行して販売力の強化に寄与すべく、米国の新規ベンダーと販売代理契約を締結、複数のビジネスパートナー社の新製品の販売も開始いたしました。また、日本の半導体人材育成に資することを目的とした有明高専との



代表取締役社長

松尾和利

のライセンス使用契約の締結を行う等、産学官の連携も促進してまいりました。

当社を取り巻く電子デバイス業界の状況は、半導体関連の分野においてはパワー半導体への投資が急速に伸長し、シリコンサイクルの「谷間」からの復調傾向

にある一方で、中国市場の低迷及び地政学的リスクは継続しております。FPD (Flat Panel Display) 等の関連分野におきましては、製品のコモディティ化によって設計ツールの需要は縮小傾向にあり、市場は急速に縮小しておりますが、高性能パネル・タッチパネル等の研究開発は活況で、最先端有機パネル、スマートウォッチ等へ主力製品がシフトしつつあります。

そのような中で当社は引き続き、コア製品の競争力・販売力を強化すべく、アナログLSI設計自動化環境及び、パワーデバイス向け設計効率化機能の拡張といった重点テーマに向けた開発を継続してまいります。研究開発活動におきましては、外部技術の導入・活用を促進しながら、デバイス設計部門との連携強化に基づいた設計者目線の製品づくりを進めてまいります。営業活動におきましては、活動の軸足をハイブリッドからリアルへ移すことで顧客との対話の機会を増加させ、顧客の課題に寄り添いながら、半導体製造装置、テスト、検査分野、素材分野等の分野の新顧客層を開拓してまいります。また海外半導体市場の拡大に向けては、大規模フォトマスクデータブラウザ：HOTSCOPEの販促活動を強化、重点海外パートナー企業を定めた「プラットフォーム」戦略の促進に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

特集 営業技術本部 技術1部長に聞く

EDAツールとシームレスに融合する革新的な電磁界解析 Lorentz社との融合による新たな付加価値の提供

2023年9月、ジーダットは、最先端のテクノロジーソリューションを提供するLorentz Solution, Inc. (本社：Santa Clara, California, U.S.)と販売代理店契約を締結いたしました。

Lorentz社は、半導体設計・検証に電磁界解析を取り入れたEDAソフトウェアプラットフォームをいち早く開発し、全世界の電子機器及び半導体のトップ企業に高く評価、採用されているソフトウェアベンダーです。

次世代の大容量無線通信ネットワークの実現に向け、Lorentz社との融合で生まれる新たな付加価値について、営業技術本部技術1部長 六川 裕幸に聞きました。

電磁界解析とは何ですか？

近年、携帯電話の通信やワイヤレスイヤホンなどのBluetooth通信、また地上波テレビなど、私たちの日常生活は電波（電磁波）を使うことにより、飛躍的に利便性が向上してきました。しかしながら、時にはその目に見えない電波（電磁波）の影響で、例えば雑音といった、私たちの日常生活に望ましくない影響が起こることがあります。そのような目に見えない電磁波の振る舞いをシミュレーションによって目に見えるようにすることを「電磁界解析」と呼びます。そのシミュレーションを行うソフトウェアが「電磁界解析ツール」です。

どのような分野の設計で電磁界解析が行われていますか？

携帯電話や地上波テレビなどの通信や放送に電波（電磁波）が使われているのはイメージしやすいと思いますが、電磁波というものは、電気信号が流れるところには大きさの違いはあれ、必ず発生するものです。半導体デバイスは電気の信号を扱いますの

で、それらの開発、製造を行っているジーダットのお客様の多くは、電磁波とは切っても切れない関係にあります。その中でも特に電磁界解析が重要になるのは、高速・高周波の信号を扱う半導体デバイスを開発される電子機器メーカーです。

高速・高周波の信号を扱う半導体デバイスはどこで使われていますか？

電磁波を使用するIC（LSI）は、携帯電話やBluetooth通信機器などの無線通信端末、高速データを使用するIC（LSI）は、パソコンやモバイル端末などの高速データ通信端末で多く使われています。特に、これから一段と重要度を増していくであろうAIや、5Gから将来の6Gといった最新・次世代の無線通信規格においては、高周波信号や膨大な量のデータを高速で伝送することがますます必要になっていくため、実際にデータ伝送を行う基本機能・性能に関わって最終製品の基本機能・性能を左右する可能性がある電磁波解析の必要性・重要性は、いやがうえにも大きくなっていきます。



営業技術本部 技術1部長
六川 裕幸

電磁界解析が難しいのはどのようなところですか？

私たちの生活の周りには、目には見えませんが常に多くの種類の電磁波が存在しています。そのため、現実には何か問題が起こったとして、「その問題となる部分だけを取り出して測定する」ということが大変難しい点です。ですから、電磁界解析のシミュレーションによって得た結果を実際の製品にどのように反映するか、設計者の判断が要求されます。高速・高周波の信号を扱うIC（LSI）製品は、どのような製品も半導体チップだけでは機能せず、必ずパッケージと呼ばれる容器に収められ、プリント基板に搭載されてはじめて機能を発揮します。電磁界解析は、IC（LSI）チップ単体の性能だけではなく、パッケージやプリント基板に搭載されたときの、より実際に近い状態での性能をシミュレーションによって求めることを可能にしています。電磁界解析によって信号速度の劣化を抑えたり、問題となる箇所を特定して改善できるため、IC（LSI）製品の性能を向上、特性を改善させることが可能になります。

Lorentz社はどのような会社ですか？

Lorentz社は2003年に米国のサンタクララで設立されたソフトウェアベンダーで、当初から電磁界解析を応用したシミュレーションツールを開発・販売してきました。世界の主要な半導体ファウンドリ会社のPDK（Process Design Kit）や、メジャーな半導体設計プラットフォームと組み合わせ使用できる設計環境を提供しています。Lorentz社の電磁界解析ツールの特徴は、複雑な構造・大きな構造を解析しても、シミュレーションの規模が大きくなりやすい点です。さらに、専門的な説明は割愛しますがシミュレーションの精度を高めるための手法を盛り込んでおり、解析手法について特許も取得しています。短時間で精度の良い解析を実現できることが大きな強みのひとつです。

ジーダット製品との相乗効果はありますか？

Lorentz社の製品を使用して得られる解析結果は、IC（LSI）内のレイアウト設計と、IC（LSI）を搭載するパッケージ・プリント基板のレイアウト設計に反映されます。また、これらのレイアウト設計に際しては、回路シミュレーション（SPICEシミュレーション）を実行します。ジーダットの自社開発製品であるSX-Meisterはもちろん、以前からのパートナーであるSimplifyDA社やPrimarius社の製品は、Lorentz社の製品適用の範囲をパッケージやプリント基板の設計、及びSPICEシミュレーションに反映させる上で、非常に重要なツールです。これらのツールを組み合わせることで、シミュレーション・設計において相互に結果を活用しながら製品の性能を上げることで、お客様にこれまでにならぬ付加価値を提供してまいります。

● デバイス設計受託の売上が伸長、助成金収入や為替差益等により大幅な増益

当事業年度における、当社の主要顧客である半導体やFPD (Flat Panel Display) 等をはじめとした電子部品業界は、中国市場の低迷の回復が予測できない中、スマートフォンやパソコン等の一部電子部品の需要減速が終息し、在庫調整も終え復調傾向の状況を呈しております。さらに省エネルギー化そしてEV化の普及によりパワー半導体の需要が伸長している状況となっております。FPD市場においては、テレビ用の大型液晶パネルの単価下落が一段落し復調傾向の状況となっております。さらに車載用の液晶パネルは大型化及び高付加価値化により需要が高まっております。

こういった状況の中、当社は産官学との協力関係を深めアナログ半導体向け設計環境の効率化を追求し続けており、主力製品であるSX-MeisterにおけるアナログLSIの設計自動化に向けたACC (Analog

Chip Compiler) 製品及びパワー半導体向け製品の開発力を強化し、6月と2月に最新の自動化機能を実装したバージョンをリリースいたしました。国内の販売促進活動においては、4年ぶりとなる対面式のプライベートセミナーを開催し、また新たな代理販売製品に関するウェビナーを開催し特長を積極的にアピールしました。海外市場においては、半導体市場向けに大規模フォトマスクデータブラウザ:HOTSCOPEの拡販にも注力し売上に貢献しました。デバイス設計受託サービスにおいては、国内の設計委託の活発な需要を受け、大幅に売上を伸ばしました。

これらの活動の結果、当事業年度の売上高はデバイス設計受託が伸長したこともあり20億60百万円(前年比2.1%増)となり、営業利益は3億2百万円(同13.1%増)となりました。経常利益は、助成金収入に加え大幅な円安による為替差益等により3億

74百万円(同17.9%増)となりました。当期純利益は、外国税控除等を適用した結果3億28百万円(同23.4%増)となりました。

● FPD顧客向けの売上は減少も、アナログICの需要の高まりによるデバイス設計委託需要の拡大を受けソリューション売上高が大幅に増加

製品売上高は11億26百万円(前期比3.1%減)となりました。

製品売上高が減少した主な理由は、第1四半期のFPD顧客向けの売上減少の影響を受けたこと並びに国内顧客の設備投資の延期によるもの等であります。引き続き国内外の市場に向けた積極的な営業活動を展開してまいります。

保守サービス売上高は4億20百万円(前期比0.4%増)となりました。

保守サービス売上高が増加した主な理由は、国内市場の縮小傾向に逆行するべく、積極的な新機能提案活動に加えて保守契約の締結促進を実施した結果、保守契約の減少を凌駕したことによるものであり

ます。引き続き顧客ニーズに合わせたサポート・サービスの向上に努めてまいります。

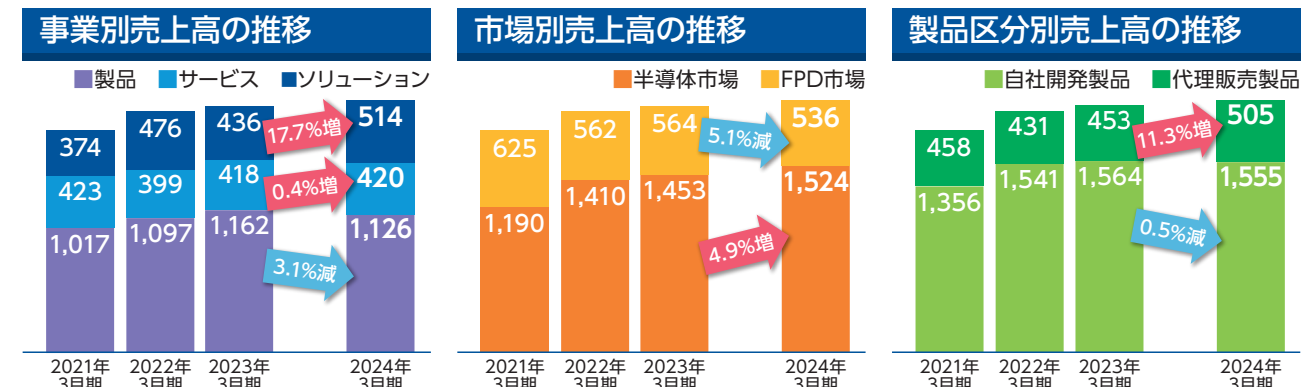
ソリューション売上高(受託開発等)は5億14百万円(前期比17.7%増)となりました。

ソリューション売上高が大幅に増加した主な理由は、アナログICの需要の高まりによるデバイス設計委託需要の拡大を受けて伸長したことによるものであります。引き続き半導体関連の既存顧客の売上拡大に加えて、新規顧客の開拓を積極的に進めてまいります。

(単位：百万円)

	2021年3月期		2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	対前期比
売上高	1,815	100.0%	1,973	100.0%	2,017	100.0%	2,060	100.0%	+2.1%
売上総利益	1,136	62.6%	1,264	64.1%	1,305	64.7%	1,288	62.5%	△1.3%
販売費及び一般管理費	1,002	55.2%	1,045	53.0%	1,038	51.5%	985	47.8%	△5.0%
営業利益	134	7.4%	218	11.1%	267	13.2%	302	14.7%	+13.1%
経常利益	150	8.3%	276	14.0%	317	15.7%	374	18.1%	+17.9%
当期純利益	101	5.6%	169	8.6%	266	13.2%	328	15.9%	+23.4%

(単位：百万円)



貸借対照表

(単位:千円)

科目	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)	科目	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
資産の部			負債の部		
流動資産	4,180,274	4,198,255	流動負債	1,184,744	977,658
※ 現金及び預金	3,644,221	3,485,575	買掛金	115,999	63,107
受取手形	734	—	未払金	23,268	46,040
電子記録債権	167,852	235,745	未払費用	37,235	48,154
売掛金	312,401	418,656	未払法人税等	21,419	49,073
仕掛品	—	2,805	前受金	866,855	637,084
原材料	199	4,373	預り金	10,034	17,664
前渡金	11,146	9,740	賞与引当金	94,161	106,859
前払費用	37,968	37,086	その他	15,769	9,674
その他	5,748	4,273	固定負債	3,700	3,700
固定資産	310,525	317,913	資産除去債務	3,700	3,700
有形固定資産	31,615	22,684	負債合計	1,188,444	981,358
無形固定資産	22,403	18,032	純資産の部		
投資その他の資産	256,506	277,196	株主資本	3,302,355	3,534,810
投資有価証券	124,590	138,567	資本金	762,524	762,524
長期前払費用	10,114	667	資本剰余金	893,443	893,443
繰延税金資産	80,941	99,033	利益剰余金	1,675,027	1,907,482
その他	40,859	38,927	自己株式	△ 28,639	△ 28,639
資産合計	4,490,799	4,516,169	純資産合計	3,302,355	3,534,810
			負債純資産合計	4,490,799	4,516,169

※「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表「現金及び預金」との差異は、主に預入期間3ヶ月を超える定期預金9億円等によるものであります。

損益計算書

(単位:千円)

科目	前事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
売上高	2,017,954	2,060,890
売上原価	712,563	772,769
売上総利益	1,305,391	1,288,121
販売費及び一般管理費	1,038,306	985,968
営業利益	267,084	302,152
営業外収益	50,290	74,213
営業外費用	0	2,328
経常利益	317,374	374,037
特別利益	39	—
税引前当期純利益	317,414	374,037
法人税、住民税及び事業税	62,964	63,441
法人税等調整額	△11,935	△18,092
当期純利益	266,385	328,688

株主資本等変動計算書

(単位:千円)

自2023年4月1日 至2024年3月31日

	株主資本								純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	
		資本 準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計			
2023年4月1日残高	762,524	893,075	368	893,443	1,675,027	1,675,027	△28,639	3,302,355	3,302,355
当期変動額									
剰余金の配当					△96,233	△96,233		△96,233	△96,233
当期純利益					328,688	328,688		328,688	328,688
当期変動額合計	—	—	—	—	232,455	232,455	—	232,455	232,455
2024年3月31日残高	762,524	893,075	368	893,443	1,907,482	1,907,482	△28,639	3,534,810	3,534,810

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科目	前事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	311,153	△65,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,082	△3,357
財務活動によるキャッシュ・フロー	△74,922	△96,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	980	1,663
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	185,128	△163,111
現金及び現金同等物の期首残高	2,525,708	2,710,836
※ 現金及び現金同等物の期末残高	2,710,836	2,547,725

1株当たり情報

1株当たり純資産	918円29銭
1株当たり当期純利益	85円39銭

トピックス |

● インテリクチュアルハイウェイ株式会社と販売代理店契約を締結

2023年7月、ジーダットは最先端のテクノロジーソリューションを提供するインテリクチュアルハイウェイ株式会社(神奈川県横浜市)と販売代理店契約を締結いたしました。インテリクチュアルハイウェイのネットワークアクセラレータIPは従来のソフトウェアと比較して圧倒的に高性能なネットワーク処理と堅牢なセキュリティを実現します。インテリクチュアルハイウェイの持つ高性能ハードウェア・ネットワークアクセラレータIPを中心とした革新的な製品技術と優れたサービスの販売代理店として相互協力することで、ますます高度化・複雑化するお客様のニーズに応えてまいります。

● Lorentz Solution, Inc.と販売代理店契約を締結

2023年9月、ジーダットは最先端のテクノロジーソリューションを提供するLorentz Solution, Inc. (California, U.S.)と販売代理店契約を締結いたしました。Lorentz社は、IC設計・検証に電磁界解析を取り入れたEDAソフトウェアプラットフォームをいち早く開発した企業であり、Lorentz社が提供する設計プラットフォームは、LSIからパッケージ・基板に至るまでのデバイス設計・検証のシミュレーションを高精度で実現します。

● 容量抽出ツールをアナログLSI設計向けに販売を開始

2023年10月、ジーダットは2022年に液晶・OLEDパネル向けに発表した容量抽出ツール SuperCap RXを、アナログLSI設計向けに販売を開始しました。SuperCap RXは、アナログLSI設計のフロアプラン段階で、配線寄生容量を高速、高精度に抽出することができます。SX-MeisterによるアナログLSI設計フローの早期段階で電源や主要配線を解析し、LVS検証なしで解析できるため、手戻りを削減し、設計期間を短縮します。

● カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」とのスポンサーシップ契約を締結

ジーダットは、スポーツを通じた社会貢献活動の一環として、2023年6月1日にカーリングチーム「ロコ・ソラーレ」とのスポンサーシップ契約を締結いたしました。ロコ・ソラーレは2018年平昌オリンピックでの銅メダルに続き2022年北京オリンピックで銀メダルを獲得いたしました。ロコ・ソラーレはカーリング競技の発展に大きく貢献しております。ジーダットはロコ・ソラーレがさらなる活躍ができるよう応援しています。

● YouTubeチャンネルを開設

ジーダットは公式YouTubeチャンネルを開設いたしました。決算説明動画などを配信してまいります。当社についてさらにご理解を深めていただければ幸いです。チャンネル登録
よろしくお祈いします。



https://www.youtube.com/@JEDAT_Official

会社概要/役員 |

(2024年6月19日現在)

会社概要		役員	
商号	株式会社ジーダット (Jedat Inc.)	代表取締役	松尾 和利
所在地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲	取締役常務	小川 尚史
代表者	代表取締役社長 松尾 和利	取締役	藤澤 義麿
営業開始	2004年2月2日	取締役	長谷部 邦雄
資本金	762,524,260円 (2024年3月31日現在)	社外取締役	坂本 和彦
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション・半導体集積回路の設計受託	社外取締役	渥美 滋
		監査役(常勤)	小川 泰
		社外監査役	日比野 好恵
		社外監査役	小松 弘明